

本文目录

- [电镀vcp线工艺流程？](#)
- [pcb电镀时间一般多长？](#)
- [PCB填孔电镀用什么电镀？](#)
- [东威科技创始人？](#)
- [PCB电镀孔面铜偏薄什么原因导致的？](#)

电镀vcp线工艺流程？

VCP电镀工艺的一般流程为：上料→微蚀→三级水洗→预浸→镀铜→三级水洗→抗氧化→二级水洗→烘干→下料→剥挂→剥挂水洗→夹具干燥→上料。頭條萊垎

在进行电镀工艺时，PCB板会被固定在电镀挂具上，接通电流进行电镀。电镀挂具起到了固定和导通两个作用，是电镀工艺的关键部件。目前用垂直线电镀设备的电镀挂具的挂具头与夹具的电性连接不可靠，会影响电镀质量。同时现有的VCP夹具主要采用螺杆固定PCB板，因为PCB板和螺杆的端是点接触，压力集中，容易损坏PCB板，另外，点接触也导致电流分布不均匀，影响电镀的均匀性；其次，PCB板可能需要4个或者更多的电镀夹具将PCB板夹住，然后再拧紧螺杆固定PCB板，导致操作员效率低；然后，当PCB板厚度不同时，来回拧紧或者松动螺杆，会使得螺杆容易松动，特别在电镀设备振动的时候，PCB板很容易脱落，影响电镀效果。萊垎頭條

pcb电镀时间一般多长？

pcb电镀时间一般是大概需要2个小时。在电镀中常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性，该技术称为指排式电镀或突出部分电镀。萊垰頭條

在电镀中也常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上，金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术，目前接触插头或金手指上的镀金已被镀铅、镀钮所代替。萊垰頭條

PCB填孔电镀用什么电镀？

普通电镀和镀盲孔电镀在铜槽液基本配比上就有区别，普通电镀是高酸低铜，保证良好的深镀能力，而填孔电镀是高铜低酸，因此相对深镀能力就差些。不过填孔板一般较薄，可以满足深镀要求。光剂比例也有影响。萊垰頭條

东威科技创始人？

创始人是刘建波，东威科技东威成立于2001年，是一家集研发、生产、销售为一体的设备制造企业。公司立志于PCB(印制电路板)电镀设备的深入研究，专业、专注。公司以追求PCB业界较佳生产力为己任，不断提高PCB电镀技术，并提供前沿的PCB电镀设备。頭條萊垰

公司以生产传统PCB一次铜、二次铜、电镀镍金、PTH、黑氧化等设备为基础，力推新型技术产品— PCB垂直连续电镀(VCP)，并逐步推出一系列与此相关的垂直连续电镀设备，條萊垰頭

PCB电镀孔面铜偏薄什么原因导致的？

孔铜问题是电路板的至命缺陷，不可小视萊垰頭條

电流输入过低，积分面积或电流密度给错萊垰頭條

药水组分失控，深度能力差、萊垰頭條

缸内铜离子浓度偏低萊垰頭條

图形分布不均匀，电镀均匀性差萊垰頭條

夹具夹点导电性差，电流流通性差萊垍頭條

V座过热导致板件上电流雨输入的电流差异较大垍頭條萊